Crème à braser sans nettoyage, absolument sans halogènes et sans plomb

RoHS compliant

Description

IF 9057 est une crème à braser sans nettoyage, absolument sans halogènes et sans plomb qui a été développée pour une meilleure stabilité sur le pochoir et des résidus transparents après la refusion.

La crème à braser fonctionne très bien pour les applications de refusion des composants traversants ('Pin-in-Paste', 'PiP'). La rhéologie donne une excellente adhésion aux surfaces du trou traversant et des pattes du composant. Ça évite que la crème à braser tombe et cela résulte en un remplissage excellent du trou traversant.

La crème à braser IF 9057 fonctionne très bien en phase vapeur. Le résidu ne s'étend pas et le phénomène 'd'effet Manhattan' est réduit fortement en comparaison avec des autres crèmes à braser. Pour une réduction optimale du phénomène 'd'effet Manhattan', la version ATL de l'alliage est recommandée (Voir disponibilité).

Les résidus après la refusion sont transparents et faible en quantité. Les résidus sont compatibles avec le test 'in situ'.

La crème est absolument sans halogènes ce qui garantit une fiabilité supérieure des résidus après le brasage.

La crème à braser est classée RO L0 suivant les normes IPC et EN.

La photo n'est pas contractuelle

Avantages

- Excellents résultats en refusion des composants traversants ('PiP')
- Anti 'effet Manhattan'
- Fonctionne très bien en phase vapeur
- Grande stabilité et durée de vie sur le pochoir
- Peu de résidu transparent
- Absolument sans halogènes

Disponibilité

alliages	Point de fusion	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn96,5Ag3Cu0,5	~217°C	sérigraphie: ~ 88.5% dosage: ~ 85%	type 3 type 4 type 5 conditionnel	pot :500g seringues: 10CC/30CC
ATL SnAgCu (Anti-'effet Manhattan')	~217-227°C			
Sn99Ag0,3Cu0,7	~217-227°C			
autres alliages sur demande				autres conditionnements sur demande

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

ISO 9001

Recommendations pour le profil de refusion de la IF 9057

En général un profil de refusion avec un palier court est recommandé. Des profils de type linéaire ou avec un palier sont également possibles. .Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer ou éliminer la présence de « voids ».

Pendant la refusion sans plomb, il faut être attentif de ne pas surchauffer les composants, surtout avec les fours de type convection et infrarouge. Il est très important de connaître les limitations de température des composants du circuit. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, utilisez des thermocouples pour enregistrer les températures. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en température. Mesurez sur les côtés, au milieu et à proximité du convoyeur et de grandes masses thermiques.

Préchauffage

Afin de permettre l'évaporation de l'humidité absorbée et d' éviter les composants de craquer, maintenir une pente entre 1-3°C/s jusqu' à environ 200°C. Pour ça éviter des températures de convection dans la première zone supérieure a 150°C.

Palier

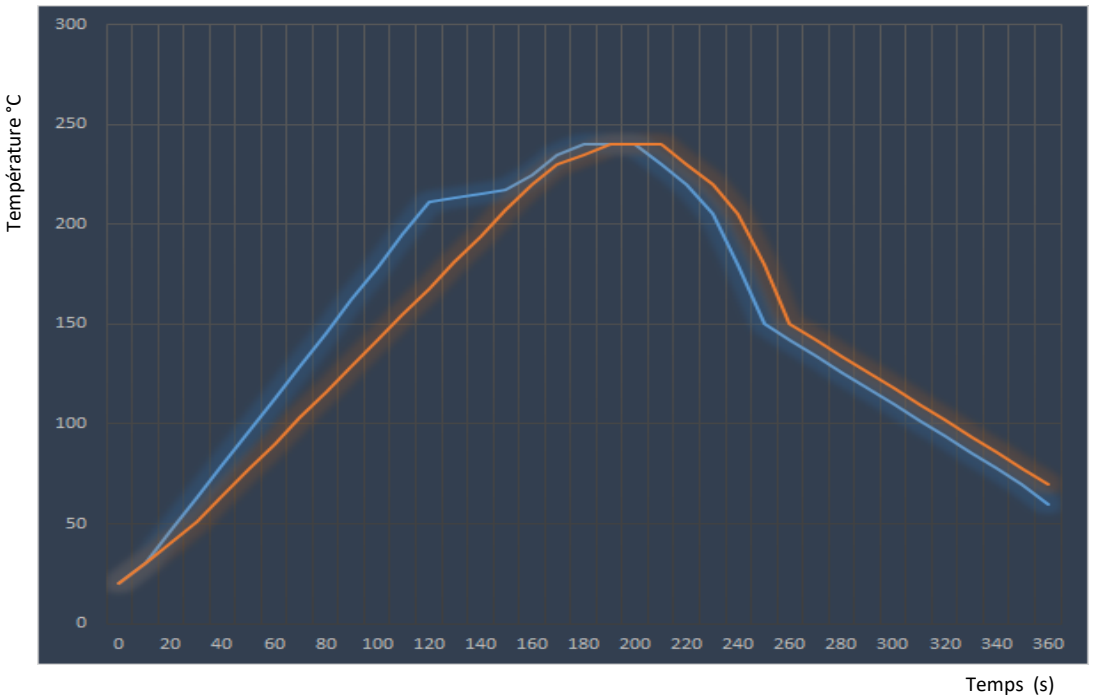
Un palier entre 200°C et 215°C pour 0-90s à 0-1°C/s peut être utilisé afin de limiter les différences de températures du circuit ou bien, pour diminuer la présence de « voids ».

Refusion

Le pic de refusion est limité par les spécifications des composants. En général entre 235°C and 250°C. Le temps au-dessus du liquidus (au-dessus du point de fusion) est en général entre 30 et 90s.

Refroidissement

Pas plus vite que - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des matériaux (composants et circuits). En général un refroidissement rapide donne des joints de soudure plus fortes.



S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 7° - 15°C. Temps de stockage : 6 mois.

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

Sérigraphie

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. Il est recommandé de presser le circuit dans le pochoir entre 0,2 en 0,4mm. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalle régulier.

Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage ISC8020 est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

Réutilisation

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme IPC J-STD-004B/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	**passe**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32D
Argent chromate (Cl, Br)	**passe**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.33D
Test tache (F)	**passe**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.35.1
Test de corrosion	**passe**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.15
Classification du flux	**RO L0**	J-STD-004B
Test d'étalement	**98 mm²**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.4.46
Test de sécheresse	**passe**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.4.47
Environnement		
Test SIR	**passe**	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.3.7
Mécanique		
Test de microbilles après 15min	**passe**	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
après 4h	**passe**	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage	**passe**	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement après 15min à 25°C	**passe**	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
après 10min à 150°C	**passe**	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

Santé et Sécurité

S'il vous plaît, toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Recommandations et paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse:	25—100 mm/sec
Pression sur les racles:	250g—350g/cm
Intervalle de nettoyage du pochoir:	chaque 10 circuits
Température souhaitée:	15 to 25°C
Humidité souhaitée	40% to 75% r.H.
Temps de vie sur le pochoir:	>24hrs

Assemblage CMS

Durée du pouvoir collant ('tack time'):	>8 hrs

Refusion

Profil:	linéaire, palier
Type de four:	convection, phase vapeur, ...

Test "in situ":

appropriée pour: "flying probe"
Planche à clous

Nettoyage

Le nettoyage de la crème des pochoirs et des racles est recommandé avec Interflux® ISC 8020.

Les résidus après refusion de la crème IF 9057 sont très fiables et n'ont pas besoin de nettoyage, mais ils peuvent être nettoyés si cela est désirable.

Nom commercial du produit : IF 9057 No-Clean, Halide Free, Lead-Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS N.V.

la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com